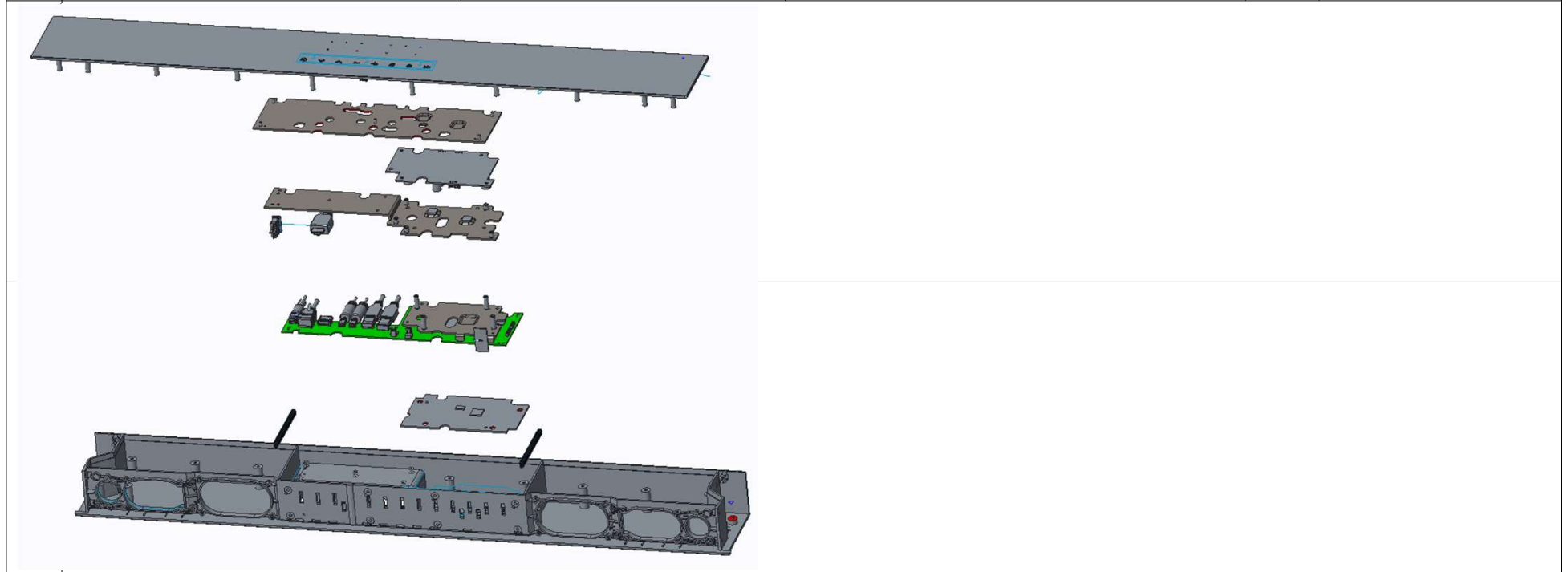


- 모델명: BFX-UA300
- 부품명: Heat spreader_AMP_Top_PCBA+Thermal
- 제작처(Mold, Press): TBD / 조립양산처: TBD
- 내용: PCBA+Thermal 개선안 모델링data 3차 입수 및 기구검토_8/4

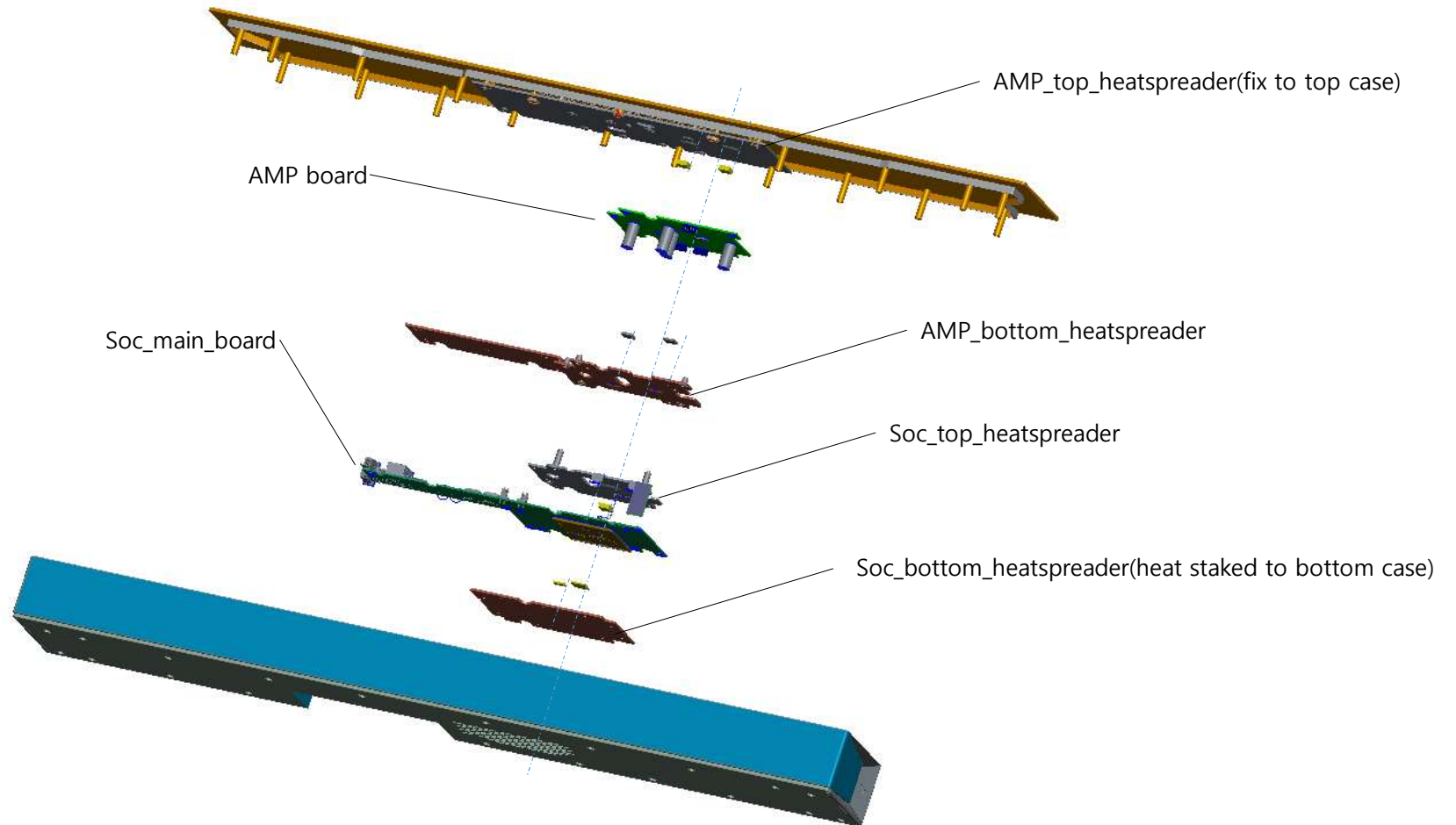
4 AUG 2020

NO	내용/문제점	목적/원인	대책	일정	비고
116	PCBA 모델링data 3차 입수 및 기구검토	Thermal 개선안 접수_ALT팀 제안	1. 조립/생산성 난해, PCBA+Thermal Assy +컨넥터류 cabling조건외 모듈화 필요 2. board상에 보스영역 도피홈 필요. 3. 철판Press물(t=2.0) 열용착 고정 비효율	8/4	상세: ** 3D data 참조 요망



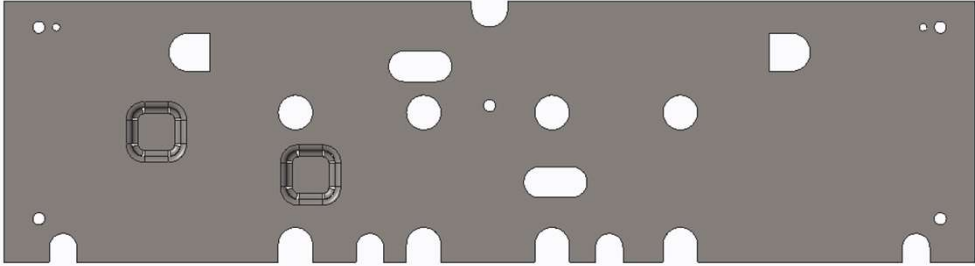
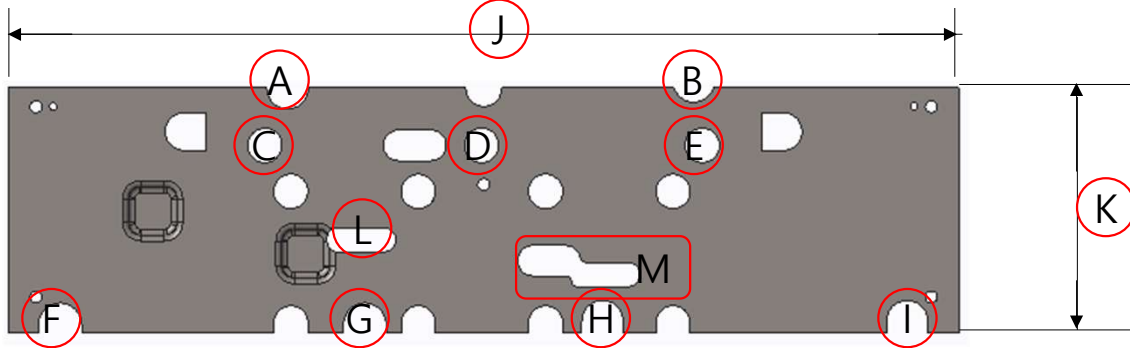
C:\W01_drawing\wsm205_skbb_soundbar\W2008041330_bfx_ua300\W2008041446_3d_forALT&Foxconn\W

Thermal design



- 모델명: BFX-UA300
- 부품명: Heat spreader_AMP_Top_PCBA+Thermal
- 제작처(Mold, Press): TBD / 조립양산처: TBD
- 내용: PCBA+Thermal 개선안 모델링data 3차 입수 및 기구검토_8/4

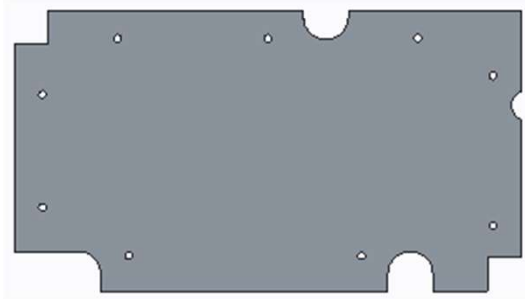
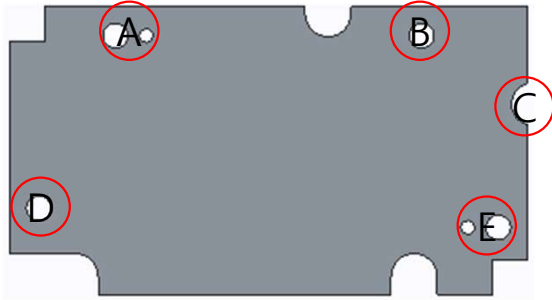
4 AUG 2020

NO	문제점	원인	대책	일정	비고
117	기구물 형합 방해_간섭	Thermal 개선안_ALT/Foxconn 팀	13개소 형상 반영_A~M 부 가로/세로 SIZE 축소_J,K 부	8/4	상세: ** 3D data 참조 요망 heatspreader_amp_top_30_1.stp
표기전	A~M 부 없거나, 작음 J: 280mm K: 75mm				
표기후	A~M 부 조건 반영 J: 276mm K: 71mm 참고로,,, L,M부의 경우, Mic 위치(커브or 직선) 확정 후 형상화 필요				

C:\W01_drawing\wsm205_sbbb_soundbar\W2008041330_bfx_ua300\W2008041446_3d_forALT&Foxconn\

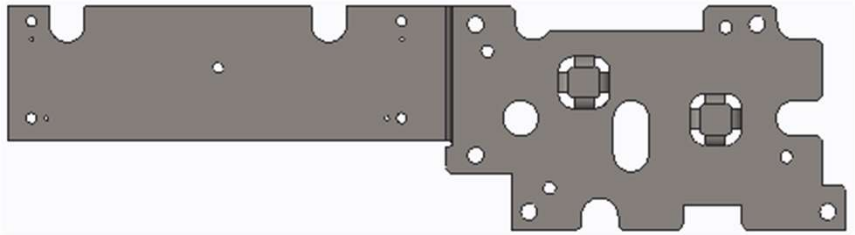
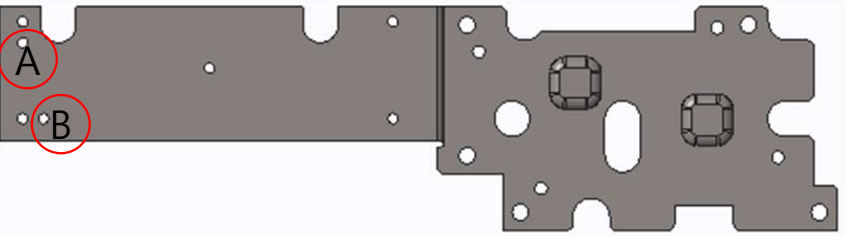
- 모델명: BFX-UA300
- 부품명: Heat spreader_SOC_Bottom_PCBA+Thermal
- 제작처(Mold, Press): TBD / 조립양산처: TBD
- 내용: PCBA+Thermal 개선안 모델링data 3차 입수 및 기구검토_8/4

4 AUG 2020

NO	문제점	원인	대책	일정	비고
118	기구물 형합 방해_간섭 공정불량 시, 손실비용 큼	Thermal 개선안_ALT/Foxconn 팀	5개소 형상 반영_A,B,C,D,E부	8/4	상세: ** 3D data 참조 요망 heatspreader_soc_bottom_15_1.stp
표기전	** 				
표기후	** 				

- 모델명: BFX-UA300
- 부품명: Heat spreader_AMP_Bottom_PCBA+Thermal
- 제작처(Mold, Press): TBD / 조립양산처: TBD
- 내용: PCBA+Thermal 개선안 모델링data 3차 입수 및 기구검토_8/4

4 AUG 2020

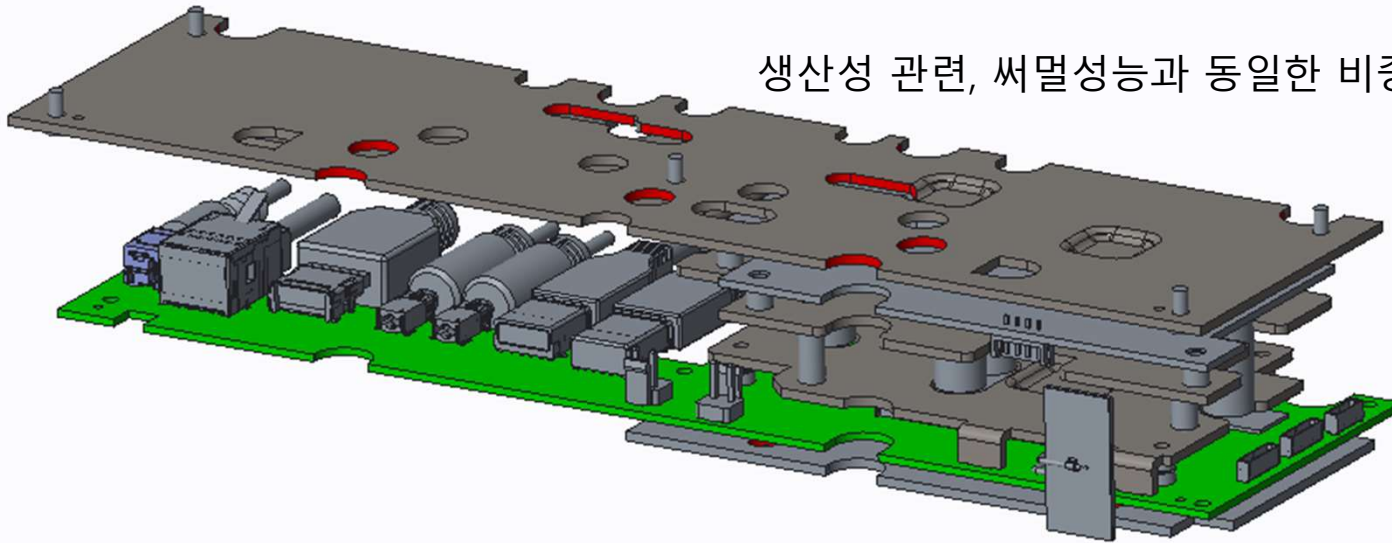
NO	문제점	원인	대책	일정	비고
119	공정불량 시, 손실비용	Thermal 개선안_ALT/Foxconn 팀	5개소 형상 반영_A,B,C,D,E부	8/4	상세: ** 3D data 참조 요망 heat_spreader_amp_bottom_36_1.stp
표기전	3D model of the heat spreader_AMP_Bottom_PCBA+Thermal part, showing the current design with two circular features highlighted by red circles. 				
표기후	3D model of the heat spreader_AMP_Bottom_PCBA+Thermal part, showing the revised design with two circular features highlighted by red circles and labeled A and B. 				

- 모델명: BFX-UA300
- 부품명: Module_PCBA+Thermal Ass'y
- 제작처(Mold, Press): TBD / 조립양산처: TBD
- 내용: PCBA+Thermal 개선안 모델링data 3차 입수 및 기구검토_8/4

4 AUG 2020

NO	문제점	원인	대책	일정	비고
120	Cable포선 정보 없음 Module_PCBA+Thermal Assy	Thermal 개선안_ALT/Foxconn 팀	Cable포선 정보공유 요망. 입수 후, 포선 구조 적용예정	8/4	상세: **

생산성 관련, 써멀성능과 동일한 비중으로 중요



- 모델명: BFX-UA300
- 부품명: Module_ PCBA+Thermal Ass'y
- 제작처(Mold, Press): TBD / 조립양산처: TBD
- 내용: PCBA+Thermal 개선안 모델링data 3차 입수 및 기구검토_8/4

4 AUG 2020

이 검토서의 내용에 대해서
의사결정을 최대한 빠르게 주셔야
Mock up제작용 data역시 update가 이뤄 집니다.

***Pending사항

1. PCBA + Thermal assy 사양 >>> 일정 회신 요망
2. Cable 포선정보, Cable사양_밀폐조건을 위한 기구물 설계에 필요 >>> 일정 회신 요망
3. Acoustics 사양_Port조건 >>> 일정 회신 요망